



第 **63** 期

中間
株主通信

2025年4月1日～2025年9月30日
2025年12月発行

BUSINESS REPORT for shareholders

CONTENTS

株主の皆さまへ	P2
特集—生成AI半導体に貢献する	P4
最先端のウシオの露光装置	
Pick Up	P5
会社情報	P6

新成長戦略は概ね計画通りに進展中。引き続き各施策を着実に推進することで、目標の達成及び企業価値向上を目指します。



代表取締役社長

羽田 勝文

Q1 > 米国関税、為替等、事業環境に対する認識と貴社への影響について教えてください。

世界情勢が急速に変化する中、当社の売上高の約7割は海外(日本以外)での取引が占めており、米国の関税措置や為替変動が業績に一定の影響を及ぼしています。しかし、米国の関税措置については、適宜適切な対策を講じているため、現時点ではその影響は限定的であり、想定を超える影響は発生しておりません。

主にVisual Imaging事業において、中国で生産した産業用プロジェクターを米国市場に輸出する際に直接的な影響を受ける懸念がありますが、サプライチェーンの見直し等による対応を進めています。また、その他の部品や製品の商流においても追加関税によるコスト増加が懸念されますが、現時点での影響は限定的です。

為替については、海外への輸出比率が高いため、円安が業績を押し上げる効果をもたらします。主要取引通貨である米ドルの為替レートが1円変動するごとに、売上高で約±10億円、営業利益で約±1.2億円の影響があると試算しています。

今後もこれらの動向を注視し、引き続き適切な対応を講じまいります。

Q2 > 新成長戦略の進捗、業績について総括してください。

2024年5月に公表した新成長戦略は、現在2年目に入りました。1年目の各施策については、半導体市場の回復が遅れている影響はあったものの、その他の施策は計画通り着実に進捗しました。

事業戦略においては、今後の成長拡大が期待される半導体アドバンスドパッケージ(ADP)事業に注力し、計画通り将来に向けた先行投資を実施しました。一方、従来型のサーバーやPC向け半導体需要は過去の関連市場での過剰投資の影響により顧客の設備投資の回復が遅延しており、主要な露光装置の販売は当初計画を下回る結果となりました。また、半導体ADP市場では、技術的な課題などから基板の大型化が遅延しており、来期2026年度には顧客の設備投資が回復傾向となる見込みも、本格的な投資の回復や大型基板の立ち上がりは2027年度になる見込みです。足元ではこのような状況ですが、半導体ADP市場は生成AI需要に支えられ、今後、確実な市場成長が見込まれます。当社も新製品を投入するなど、この成長機会を着実に捉えてまいります。

また、事業ポートフォリオ変革も同時に進めており、テコ入れが必要な事業については製品ポートフォリオの見直しや固定費削減アクションプランを実施し、その成果が業績に反映され始めています。

インタビューは次ページに続きます →

決算ハイライト

2025年度 中間期業績実績 - 減収減益も、社内計画を上回り進捗

- デジタルリソグラフィ装置(DLT装置)は一部前倒しで売上計上。ステッパ露光装置の販売は対前年同期で減少
- DLT等露光装置関連の先行投資を計画通り拡大
- 事業ポートフォリオ変革により収益構造改善が進展

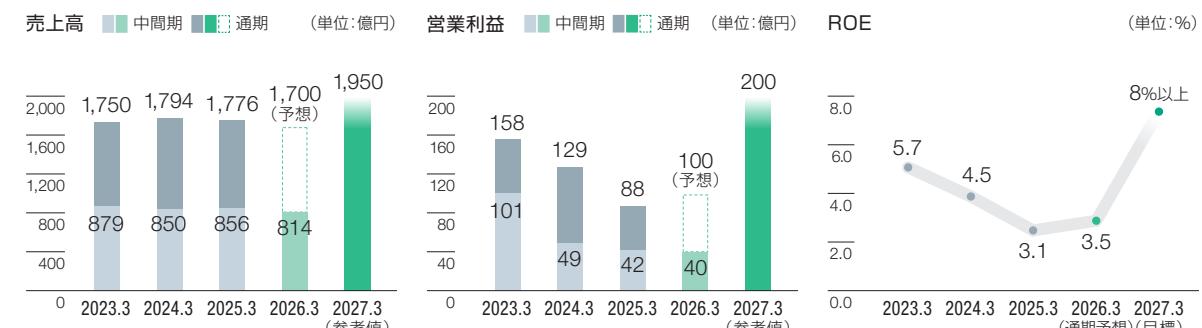
2025年度 通期業績予想 - 期初計画を据え置き

- 収益構造改善が進展も、DLT装置の本格的な立ち上がり遅延を考慮

決算のポイント

新成長戦略の進捗

- 半導体ADP事業は、将来確実に拡大する需要に備えた取り組みが着実に進展
- 事業ポートフォリオ変革の各施策は、計画通り実施



財務戦略については、新成長戦略で掲げた計画に基づき、資本効率の改善に取り組んでいます。自社株投資やバランスシートの見直しを行い新成長戦略Phase I の最終年度である2026年度のROE8%以上という目標達成に向けて、施策を着実に推進してまいります。

Q3 > 拡大する生成AI半導体需要、それが与える貴社への影響についてお聞かせください。

生成AI向け半導体の需要は急速に拡大しており、今後も成長が期待される非常に活況な市場です。当社はこの需要拡大の機会をしっかりと取り込むとともに、半導体のさらなる進化に貢献すべく、取り組みを一層強化しています。

これまで半導体の進化は、主に前工程における微細化技術によって推進されてきましたが、技術的・経済的な限界が近づいています。そこで今後は、後工程における高密度パッケージ技術が注目されており、当社はこの分野に貢献する露光装置を開発しています。

当社はすでに主要な半導体パッケージ基板向けで約90%のシェアを有する強力な製品を持っており、さらにアプライドマテリアルズ社との協業によるデジタルリソグラフィ装置(DLT装置)も2025年度より業績に貢献し始めています。先に述べた通り、大型基板の立ち上がり遅延の影響はあります。これらの技術トレンドの進化に伴い、2027年度にDLT装置の本格的な立ち上がりと、当社業績の大きな成長を見込んでいます。今後の展開にご期待ください。

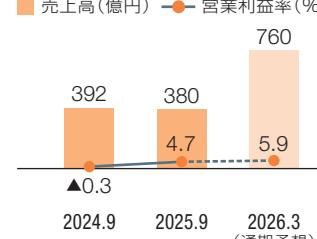
半導体アドバンスドパッケージ事業の詳細は、p.4の特集をご覧ください

セグメント情報

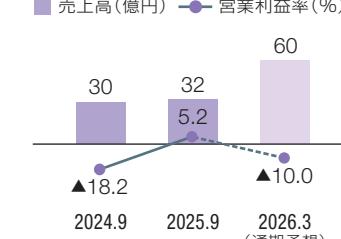
Industrial Process 事業



Visual Imaging 事業



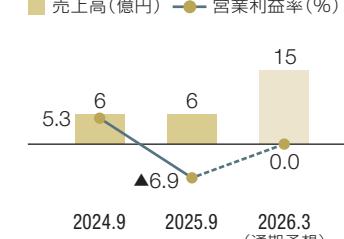
Life Science 事業



Photonics Solution 事業



その他 事業



業績情報は[こちら](#)

改善を図ってまいります。

世界情勢の変化など不透明な環境が続く中、今後もその動向を注視し、適切な対応を行ってまいります。引き続き、計画の着実な達成に向けて全力で取り組んでまいります。

Q6 > 株主の皆さまへのメッセージをお願いします。

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。私たちは現在、将来の企業価値向上と持続的な成長を目指し、2024年5月に公表した新成長戦略を着実に実行しています。創業以来、「光」を中心とした技術で、世の中の技術革新のボトルネックを解決し、社会に貢献してまいりました。これまで培ったコア技術、製造ノウハウ、人的資本を含む経営資本をさらに磨き上げ、将来の成長・発展に向けて活用していく所存です。

現在は、不採算事業の整理や事業の取捨選択を進め、最適な事業ポートフォリオへの変革を実施しています。また、成長が続く生成AI半導体市場に貢献する新たな製品であるデジタルリソグラフィ装置の販売も今期より業績に貢献し始めています。このように、収益構造改革と成長投資を両立させた事業戦略と財務戦略を進めることで、着実に企業価値を高めてまいります。

株主の皆さまのご期待に応えるべく、透明性のある経営と持続可能な成長を実現するために全力を尽くしてまいります。今後とも弊社の活動にご注目いただければ幸いです。

※ams OSRAM AG:半導体及び車載用・産業用特殊ランプ技術における世界的なリーダー、車載用、産業用、医療・消費者向けのLED、レーザー、センサー等の半導体デバイス、及び半導体製造装置向け特殊ランプ等の設計・製造・販売をしている

生成AI半導体に貢献する 最先端のウシオの露光装置

生成AIに求められる半導体

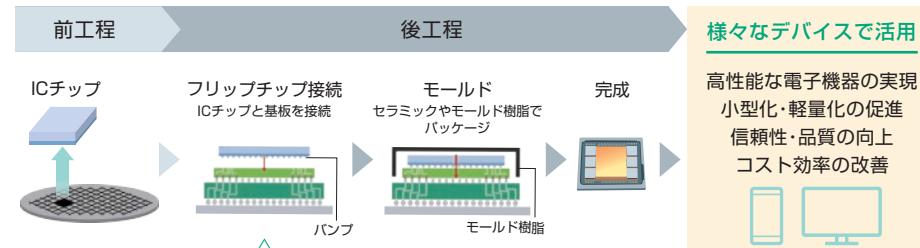
生成AIの進化により、私たちの暮らしや産業は大きく変わりつつあります。こうしたAIの普及により、より多くのデータを高速に処理できる半導体の重要性が高まっています。

これまで半導体の性能向上は、主に「前工程」と呼ばれる製造段階での微細化技術に支えられてきましたが、その進歩にも限界が見え始めています。そこで注目されているのが、「後工程」における半導体アドバンスドパッケージ技術の進展で、中でも高密度パッケージ技術が重要です。

これは、前工程で作られたICチップを高性能な基板に搭載し、基板を積み重ねることで、処理能力の向上や省エネルギー化を実現しようとするものです。そのためには、チップと基板をつなぐ配線を、より高密度かつ基板の特性に合わせて微細に仕上げることが必要です。

こうした微細な配線の形成を支えるのが、ウシオの露光装置です。

半導体製造



生成AI半導体のパッケージ図(イメージ)

前工程で作られた複数のICチップを基板上に搭載し、微細配線で高精度につなぐことで、最終製品の性能を最大限に引き出すことができます。ウシオは、この微細配線の形成に貢献する露光装置を提供しています。



* インターポーラー基板 高性能パッケージの中核を担うインターポーラー基板は、複数のチップを高密度かつ高速に接続し、安定した電力供給と信号伝達を可能にする

**サブストレート基板 従来型の基板であるサブストレート基板は、チップの搭載と外部回路との接続を担う

ウシオは、新成長戦略における事業戦略の一つとして「半導体アドバンスドパッケージ(ADP)市場での成長加速」を掲げており、生成AI半導体の製造に欠かせない露光装置を開発・製造しています。今回は、生成AI半導体の進化にとって、ウシオの半導体ADP向け露光装置がなぜ重要なのかをご説明します。

半導体アドバンスドパッケージ(ADP)市場でのフルラインアップ戦略

ウシオは、後工程の半導体ADP市場向けに、生成AI半導体で求められるさまざまなニーズに対応する3つの露光装置を、フルラインアップで提供しています。具体的には、より高度な配線技術を備えたデジタルリソグラフィ装置(DLT装置)。従来から高いシェアを持つステッパ露光装置。そして、子会社であるアドテックエンジニアリングが提供するダイレクトイメージング(DI)露光装置です。

このようにお客様の多様な配線ニーズに応えるラインアップを提供できるのは、ウシオならではの強みです。これらの露光装置は年平均成長率(CAGR)が15%と高く、新成長戦略における最大の成長ドライバーと位置付けています。

今後ウシオは、このフルラインアップ体制で、生成AI半導体の進化に貢献していきます。

DLT装置

2023年12月にアブライド マテリアルズ社と業務提携し、新しい上位機種をラインアップ。生成AI半導体で求められる微細配線(1μm以下の解像度)などの高度な要求に対応。

[p.5のTopics2をご覧ください](#)



ステッパ露光装置 (2026年度に上位新機種リリース予定)

マスクを通して面積を一括で露光することで、生産性や解像度など高い性能を有し、半導体後工程の最先端ICパッケージ基板向けにシェア90%を獲得。

[p.5のTopics1をご覧ください](#)



DI露光装置

高度なパッケージ基板をはじめ、多様な基板用途に対応し、マスクレスで柔軟かつ高精度な露光を実現する露光装置。



半導体ADP向け露光装置 ウシオグループ全体の売上推移

※イメージ

2030年に向け
年率15%
で成長

2022.3 2025.3 2027.3 2031.3



Topics 1

ウシオの投影露光技術の詳細は[こちら](#)半導体アドバンスドパッケージ(ADP)向けラインアップ拡充
— 解像度1.5 μmステッパ露光装置をリリースへ —

ウシオは、半導体ADP市場の成長を見据え、解像度1.5 μmで1ショット100mm角以上の大面积露光を実現する新型ステッパ露光装置「UX-59113」の開発を進めており、2026年度中に上市予定です。

従来のウェハ用のステッパ露光装置では、配線の微細化やパッケージサイズの大型化が進むパッケージ基板への対応に複数ショットを繋ぎ合わせて露光するステッピングが必要になつておあり、つなぎ合わせ時のズレによる歩留まりや生産性の低下が課題となっていました。この製品は、1.5 μmの高い解像力を実現するとともに、1ショットで100mm角以上の大面积をステッピングで露光することで、量産時の歩留まりと生産性の向上を可能にします。

ウシオの「UX-5」シリーズは、最先端ICパッケージ基板向け露光装置として世界シェア90%※を誇り、パソコンやスマートフォン、データセンター向けなど幅広い分野で活用されています。今回の新製品「UX-59113」では、生成AI半導体の需要に伴い重要性が高まっているインターポーラー基板にも対応し、半導体ADPの多様なニーズに応える体制を強化しています。新製品の投入により、ウシオの露光装置ラインアップはさらに充実。進化を続ける次世代パッケージ基板の技術革新に貢献してまいります。

※最先端ICパッケージ基板市場(ステッパ露光市場)における当社シェア

半導体ADP向け露光装置のラインアップ



Topics 2

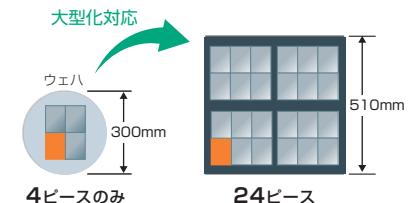
「次世代パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画」の詳細は[こちら](#)「JOINT3」にデジタルリソグラフィ技術(DLT)を提供
— 半導体アドバンスドパッケージ(ADP)市場活性化への貢献と
DLT装置のプレゼンス向上を目指す —

ウシオは、次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画しています。JOINT3は、株式会社レゾナックが設立した共創型評価プラットフォームで、材料・装置・設計の分野で世界トップクラスの企業が集結し、515×510mmサイズのパネルレベル有機インターポーラーの開発加速に取り組んでいます。

生成AIや自動運転などの分野で後工程の半導体パッケージング技術の重要性が高まる中、複数の半導体チップを並列に配置し、中間基板(インターポーラー)を介して接続し実装する2.xDパッケージの需要が拡大しています。インターポーラーは半導体の性能向上に伴いサイズの大型化が進み、従来のシリコン材料から有機材料への移行も進んでいます。

従来は円形ウェハから四角片を切り出す手法が主流でしたが、インターポーラーの大型化により、1枚のウェハから取れる数が減少するという課題が生じています。これに対し、円形のウェハ形状から四角いパネル形状へ変更し、より多くのインターポーラーを効率的に生産する製造プロセスが注目されています。JOINT3では、515×510mmサイズのパネルレベル有機インターポーラー試作ラインを用いて、最適な材料・装置・設計ツールの開発が推進されています。

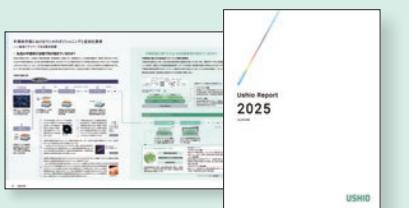
ウシオは、JOINT3において、アプライド マテリアルズ社との業務提携によるDLTを用いた半導体ADP製造プロセスの課題解決に取り組んでいます。この活動を通して、半導体ADP市場の活性化への貢献と、DLTを搭載したデジタルリソグラフィ装置のプレゼンス向上を目指してまいります。



統合報告書(Ushio Report 2025)を発行

統合報告書は[こちら](#)

今年の統合報告書(Ushio Report 2025)では、新成長戦略『Revive Vision 2030』の進捗状況や目標達成に向けた取り組み、ウシオの持続的成長を支えるESG経営・人財戦略など、各施策をご紹介しているほか、今後注力していく半導体分野での取り組みを特集。ウシオが築き上げてきた強みと成長への新たな挑戦をまとめた1冊になっていますので、ぜひご覧ください。



会社概要 (2025年9月30日現在)

設立	1964年3月
資本金	19,556,326,316円

役員

代表取締役社長	朝日 崇文
取締役	中野 哲男
取締役	神山 和久
社外取締役	佐々木 豊成
社外取締役	松崎 正年
社外取締役	間下 直晃
社外取締役	増山 美佳
取締役(常勤監査等委員)	木下 誠
社外取締役(監査等委員)	杉原 麗
社外取締役(監査等委員)	須永 明美
社外取締役(監査等委員)	有泉 池秋

従業員数 (2025年3月31日現在)

ウシオ電機本体	1,677名
国内連結子会社	764名
海外連結子会社	3,572名
合計	6,013名

株主メモ

証券コード	6925
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときはあらかじめ公告いたします。 なお、中間配当制度は採用しておりません。
1単元の株式数	100株
公告掲載URL	http://www.ushio.co.jp/kokoku ※やむを得ない事由により上記URLにおいて公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

株主名簿管理人及び特別口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	0120-782-031 (フリーダイヤル)
受付時間	9:00~17:00(土日休日を除く)
ホームページURL	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
よくあるご質問(FAQ)	https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal

IR活動の振り返り (2025年4月~9月)

活動	回数	内容
決算説明会	2回	四半期ごとの決算説明会を開催。 代表取締役社長が出席し、説明及び質疑応答に対応
中長期経営戦略説明会 (進捗報告会含む)	1回	代表取締役社長が出席し、説明及び質疑応答に対応
証券会社主催 カンファレンス参加	0回	代表取締役社長及びIR部門が出席し、海外機関投資家 向けに対話を実施。当中間期は参加せず

活動	回数	内容
個別面談 (スマートミーティング含む)	89回*	IR担当取締役(代表取締役社長)及びIR部門が 中心となり対話を実施 ※機関投資家63回、セルサイドアナリスト26回
個人投資家向け説明会	1回	代表取締役社長が出席し、説明及び質疑応答に対応
IR資料のウェブサイト掲載	—	決算情報、決算説明会資料(含む、質疑応答要旨)、事業 案内資料、適時開示資料、有価証券報告書、半期報告 書、株主総会の招集通知、個人投資家向け説明会資料 等をウェブサイトに掲載。

2026年3月期 決算開示日程(予定含む)

第1四半期決算
8月5日(火)第2四半期決算
11月6日(木)第3四半期決算
2026年2月6日(金)

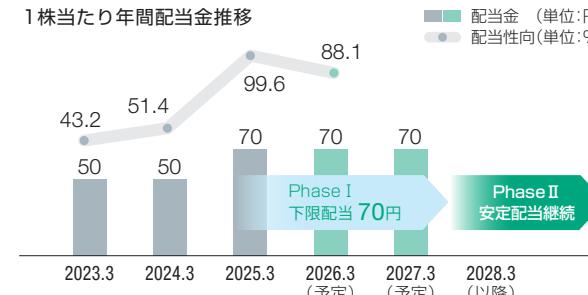
IRカレンダーはこちら

株主還元

配当方針 ▶ 安定的な配当

新成長戦略の方針
2024年度～2026年度
下限配当70円/年を設定

2025年度
70円/年(予定)

自己株式取得の方針 ▶ 機動的に実施

新成長戦略の方針
2024年度～2026年度で
累計500～600億円の自社株投資を実施予定

2025年8月5日リリース

取得期間: 2025年8月6日～2026年4月30日

買付予定金額 **200億円(上限)**
買付予定株数 **1,500万株(上限)**

自己株式取得金額推移 (単位: 億円) *2025年4月4日取得分まで含む

